



## Universeller manueller Bonder & Tester 5600

### Bond / Test System

<b>Testheads</b>	Pullheads – 100cN – 5000 cN Shearheads – 500cN – 50000 cN Tweezerhead – 100cN
<b>Bondheads</b>	5610, 5630, 5632, 5650, 5650HR

### Maschinen Basis

#### Achsen

- Arbeitsbereich X/Y-Achse 100x100mm  
Z-Achse 60mm
- Schrittauflösung 0,25µm
- Wiederholgenauigkeit <2µm

#### Hardware

- Dual Core PC, 1,6 GHz Prozessor,
- 4 GB RAM, Ethernet, 4x USB-Hub Front
- Firewire CCD Farbkamera 1,4 MPixel
- Netzwerkfähig mit TCP/IP Server

#### Software

- Datenbank(ODCB), je Draht, je Chip und Modul,  
je Bediener, je Maschine etc. Export als Excel-Datei.,
- Export Format SQL, CSV, HTML

**Geschwindigkeit** Testgeschwindigkeit von 0,2 bis 5mm/s

**Abmessung** B x T x H – 70 x 65 x 70 cm, Gewicht ca. 80kg

**Anschlüsse** 100-240 VAC, 1 Phase, 50/60 Hz, max 500 VA  
Ø 6mm Standard-Vakuumschlauch

### Der 5600:

Der einzigartige Bonder & Tester 5600 fügt sich hervorragend in das Geräteprogramm von F&S Bondtec rund ums Die- und Drahtbenden ein.

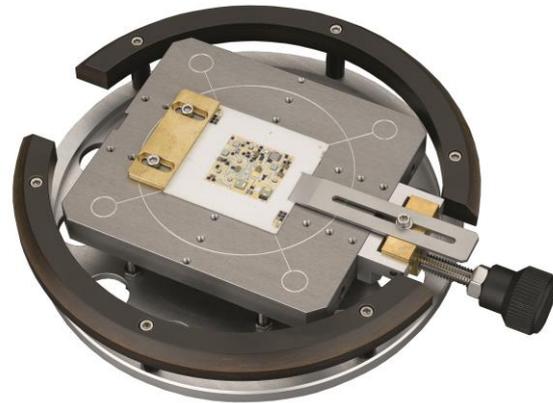
Er ist voll PC-gesteuert und kann mit seinem programmierbaren Kreuz-tisch zum automatischen Messen beliebig vieler Bonds eingesetzt werden. Die Testergebnisse können nach Wahl direkt analysiert und ausgegeben werden, oder in verschiedene Datenbanken exportiert werden.

Ein besonderer Vorteil des 5600 sind zusätzliche Messverfahren wie der Verlauf von Kraft/Zeit und Kraft/Weg, die optimalen Abschluss über den Verlauf der getesteten Bonds geben. Die wechselbaren Messköpfe machen den Pulltester flexibel für unterschiedliche Kraftbereiche; weitere Köpfe für Pull-, Shear-, und Peeltests mit kundenspezifischen Tools u. Klemmbacken sind verfügbar.

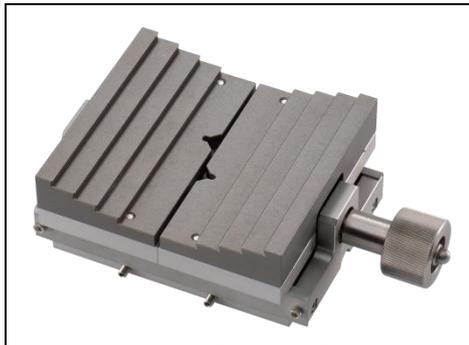
Nach erster Programmierung kann ein reproduzierbares pullen oder shearen bei allen folgenden Bauteilen garantiert werden.

## Substrathalter

Standard-Substrataufnahme  
für Bauteile bis 4x4" mit  
Vakuum und mechanischer Klemmung



## Optional:



für Bauteile bis 4x4"  
mit Stufenbacken



TO Aufnahme mit  
mechanischer Klemmung



4x4" Substrataufnahme m.  
gummierter Oberfläche, mit  
mechanische Klemmung

### F&S Bondtec Semiconductor GmbH

Industriezeile 49a

A-5280 Braunau am Inn

Tel.: +43-7722-67052-8270

Fax: +43-7722-67052-8272

Mail: [info@fsbondtec.at](mailto:info@fsbondtec.at)

Web: [www.fsbondtec.at](http://www.fsbondtec.at)

**Hilpert**  
electronics

Ihr Vertriebspartner/ Votre représentant:

Hilpert electronics AG

Täfernstrasse 29

5405 Baden-Dättwil

Schweiz / Suisse

Tel: +41 56 483 25 25

Fax: +41 56 483 25 20

Mail: [office@hilpert.ch](mailto:office@hilpert.ch)

Web: [www.hilpert.ch](http://www.hilpert.ch)

